

Stückliste (Bill of Material, BOM)

Projektname

Projektname: Beispielprojekt
Version/Revision: 1.0 / 1.3
Datum: 11/11/13

Menge	Wert / Typ	Bauform	Bauteilbezeichnung	Bauteilinformation	Lieferant	Bestellnummer	wir beigelegt	wird bestückt
2	1K47	R-EU_R0603	R1, R2	0,1%, 10ppm	Farnell	1219858	ja	ja
5	10K	R-EU_R0805	R3, R4, R5, R6, R7	1%, 125mW	Farnell	1469856	nein	ja
1	1K	207	R8	5%, RM10, 0,4W	RS	165-0915	nein	ja
2	100nF	C-EU_R0805	C1, C2	10%, X7R, 100V	Farnell	1833888	nein	ja
2	OPA177GS	SO08	IC1, IC2	OPA177GS	RS	288-828	nein	nein
3	10K	TRIM_EU-91A1A	P1, P2, P3	91A1A-B28-E15L	RS	522-5210	nein	nein

Bemerkungen:

Alle Chip Kapazitäten X7R.